

株式会社ディスコ FY21_1Q 決算 One on One Meeting FAQ

本資料について

決算発表後、アナリスト・投資家との One on One ミーティングにおいて、複数回を受けた質問項目に関して、それに対する回答を掲載しております。

将来の見通しに関する注意事項

この資料に掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。実際の業績に影響を与えうる重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

今回決算のポイント

3ヶ月前と比較して顧客の投資意欲に大きな変化は無く、7-9 月も高水準の出荷が継続する見込み

1. 業績について

●1Q（4-6 月）実績及び想定比

売上 実績 482 億円（想定比 +14 億円） 全体着地は想定から若干上振れ

想定比：「装置」若干未達 検収のタイミングによる、「消耗品」若干上振れ

G P 率 実績 60.9%（想定比 4p 弱プラス）

想定比プラスの要因

1. 為替要因 USD レート 想定 100 円 → 実勢 109.8 円
2. プロダクトミックス 消耗品の構成比上昇
3. 付加価値の増加 製品価格および稼働益による

S G & A 実績 139 億円（想定比 若干増加）

売上・利益が想定比上振れにより業績連動費用（主に人件費）が増加

O P 実績 154 億円（想定比 +22 億円） 主に為替要因・G P 率の上昇によるもの

●2Q（7-9 月）業績見通し

売上 想定 581 億円 為替想定 USD 105 円 装置検収の進捗による増収を見込む

G P 率 QoQ 低下を想定（為替がフラットでも G P 率は低下想定）

変化要因

1. 為替想定 USD 4-6 月 109.8 円 → 7-9 月 105.0 円
2. プロダクトミックス 消耗品構成比の低下
3. 足元の事情は織り込まず過去傾向値を参照し計画策定

S G & A 145 億円程度を想定 業績連動費用を見込んでおり増加傾向

O P 想定 187 億円 検収の状況次第だが、売上増加により利益率は高水準で推移見込み

2. 業績予想について

●業績予想の開示方針について（再掲）

半導体後工程は需要予測が困難なため、2018 年 4 月より「1 四半期先まで」の業績予想開示方針

例：1-3 月決算発表時に 4-6 月業績予想開示、4-6 月決算発表時に 7-9 月業績予想開示、…

●受注残高について

6 月末 925 億円（3 月末比 +236 億円）

うち未検収残高 459 億円（3 月末比 +143 億円）

うち未出荷残高 465 億円（3 月末比 +93 億円）

高い未検収残高と 7-9 月高水準の出荷継続により、顧客の検収タイミング次第だが 600 億円前後/Q の売上高推移を見込む

3. 引き合いおよび受注について

前四半期から引き続き、スマホ以外にも民生品、車載向けなど幅広い用途で顧客からの引き合いは高い水準で推移していることから、2 四半期連続で 700 億円超/Q の高い受注水準を記録

足元で引き合いの減速兆候は見られず、当社工場はフル稼働を継続、高水準の出荷が続く

●受注から出荷までのリードタイム

これまでの商慣行として、希望納期に対して余裕をもって発注書が発行されることは少なく、出荷の直前に受注計上されることが多かったことから、受注から出荷までのリードタイムが非常に短いことがほとんど

しかし、直近 1 年を振り返ると受注先行の状況が続いている

これは、世界的な半導体不足など実需に基づく装置需要が旺盛であることや、一部の後工程装置において納期の長期化が顕在化していることでダイサ・グラインダにおいても早めの調達を意識していることなどが影響していると考えられる

また、「口頭による引き合い」のキャンセルはあり得るが、発注書の発行がともなう「受注」についてはキャンセルされることは基本的に無いため、顧客も実需に基づいて従来よりも前倒しで発注書を出していると思われる

そのため、「受注から出荷までのリードタイム」は従来 1-2 ヶ月程度だったものが、足元で半年程度まで伸びている

4. 出荷動向

●4-6 月 出荷額 実績 626 億円（想定比+41 億円）

全体で上振れて着地したが、為替円安および消耗品・その他などが想定比で上振れことによるもの

為替による影響除けば「装置」はほぼ想定通りに着地

引き続き、アジア地域の OSAT 中心に量産用途の装置出荷が高水準

●7-9 月 出荷額 想定 555 億円（為替想定 105 円）

・装置 QoQ▲10%ではあるものの、引き続き高い水準の出荷が続く

・消耗品 QoQ▲5% 為替想定により減少計画だが、顧客の高い設備稼働率が続く見込み

全体の出荷額は QoQ▲10%だが、1. 為替影響、2. 4-6 月に一部製品で出荷の偏りあり、3. 「その他」製品が予測困難などの要因により、4-6 月と 7-9 月を均して考えると、概ね 600 億円/Q の出荷が継続していると捉えている

●生産キャパについて

「人員」「スペース」「部材・原材料」のうち、人員律速となっており引き続き本社・拠点からの製造支援（人員応援）を実施
スペースは、8 月に桑畑工場新棟が竣工したこともあり充足している

部材・原材料は、サプライヤからの供給がタイトになってきており、業界全体でも調達環境は厳しくなりつつあるので注意している

5. 市場環境や各アプリケーションの動向

■全体 ■ 前回決算時から顧客の投資意欲は変わっていない

■ロジック、O S A T など

5 G・スマホ関連に加えてノート P C や家電製品向けなど幅広い最終製品で需要は強いと見られ、昨年秋口から高まった O S A T 各社からロジックの引き合いは、引き続き高い水準を維持している

【補足】

先端後工程技術については、注目度は高まっているが、現時点での動きは限定的でありボリュームは少ない

引き続き研究開発に取り組んでおり、今後コスト面や最終製品への採用見込みなど動向を注視している

一方で、従来からあるパッケージングソリューションは半導体生産数量の増加トレンドに連動して高水準で推移している

■メモリ

4-6 月は主に NAND 向けで主要メモリーメーカーを中心にグラインダの出荷が増加

今後の継続性や DRAM の動向を注視している

■L E D（前回から変化なし）

一部で先端・R & D 用途と見られる引き合いが出ているが、投資金額の規模は大きく無い

最終製品への展開次第と思われ今後期待

■イメージセンサ

2020 年度上期に投資が集中した後、やや低調な推移となっていたが、足元は緩やかに回復傾向

■パワー半導体

2020 年度 4-6 月に投資が集中した後は減少傾向だったが、2021 年 1-3 月に増加に転じ、4-6 月も Si 向けグラインダを中心に続伸
四半期単位ではコンスタントに出荷が続くわけではないが、中期的には EV シフトなどの電動や省電力化ニーズに向けて各社が設備投資を行っていく
と期待している

■ウェーハメイキング

4-6 月は、アジアの新興企業を含む複数社において設備投資の動きが見られたことから高水準の出荷
足元では各地域において投資の動きがあり、今後の継続性を注視している

■電子部品

足元では目立った投資は見られず半導体と比較しおとなしい状況
今後の電子部品業界の市況などを含めて、顧客の投資動向を注視している

●消耗品の動向

4-6 月実績 顧客の高い設備稼働率などを背景に消耗品の出荷は堅調（2 四半期連続で過去最高）
7-9 月想定 引き続き高水準の出荷を見込むが、顧客の生産動向は見通しづらいため、最終製品需要の動向を含めて注視している

6. CAPEX

●大型拡張投資内訳

桑畑工場Dゾーン 2019 年 9 月着工 2021 年 8 月竣工済

茅野工場B棟 2019 年 7 月着工 2021 年 1 月竣工済

桑畑工場および茅野工場の新棟竣工後は、生産スペースとして 3,000 億円程度まで対応可能

●年間設備投資額

FY21 想定 約 140 億円 内訳：合理化投資 70 億円、桑畑工場 50 億円、他 20 億円程度

現時点ではさらなる工場建屋の投資案件は見込んでいない

ただし、考え方として今後も細かな投資案件は随時発生する可能性はある

7. DEP、経費

●減価償却

FY21 想定 75 億円前後

期初より茅野工場新棟の償却増、下期以降は桑畑工場新棟の償却増を含む

工場新棟は建屋償却のため、1 棟あたり年間 6～7 億円程度の償却額となる見込み

●販管費

FY21 想定 人員の増加および積極的な研究開発活動を継続

業績次第だが、利益連動の費用増減により 130～150 億円/Q 程度で推移する見込み

8. 配当の考え方

FY21 予想 中間 168 円（業績連動 配当性向 25%） 期末は現時点で未定（業績連動+余剰資金からの追加配当）

●配当方針のおさらい（前回同様）

業績連動による配当性向 2.5% + 余剰資金からの追加配当（詳細は説明会資料参照）

余剰資金の計算に関わる必要資金で大きな変動要因は設備拡張資金だが、大型の建屋投資は一段落

ただし、細かな投資案件は随時発生する可能性があり、積み重なりで必要資金が膨らむ場合がある

9. 今後の見方

● サプライチェーンの変化に対する考え方（前回と同様）

当社は取引先のすそ野が広く、I D M、O S A T、電子部品メーカなど多岐にわたっているため、年間の取引額は大口の販売先であっても5%程度であり、上位顧客の顔ぶれも毎年変動している
また、当社が手がけるアプリケーションも多岐にわたり、特定個社や特定用途に大きく依存していない
こうした状況を踏まえると、影響は軽微であると考えている

● 米中貿易摩擦について（前回と同様）

直接的な影響は無いが、サプライチェーンを通じた間接的な影響を注視している

ただ、上段の考え方を踏まえ、半導体需要に変化がなければ影響は軽微であると思われる

一方で、貿易摩擦の激化に伴って世界景気に悪影響が出てきた場合に半導体需要そのものが弱まるリスク、また生産拠点の見直しによる動きが本格すれば顧客の投資動向に変化が起きるため、それらの点を注視していく必要がある

● 投資意欲の継続性について

1年近く高水準の新規引き合いが継続している状況は過去に例が無く、足元も引き合いの大規模な延期、キャンセルは発生していない
引き続き、今後の最終製品動向や顧客の投資意欲を注意深く見ていく必要がある

以上